

## Microchip、IEEE 802.11a/n/ac アプリケーション向け 50 Ω 整合 5 GHz WLAN フロントエンド モジュール新製品を発表

モバイル機器、マルチチャンネル アクセスポイント/ルータ、セットトップ ボックス向け  
超高データレートを小型パッケージで実現した高効率の SST11LF04

2013 年 12 月 19 日[NASDAQ:MCHP] – マイクロコントローラ、ミックスドシグナル、アナログ、Flash-IPソリューションのトッププロバイダであるMicrochip Technology Inc. (日本支社: 東京都港区浜松町、代表: 吉田洋介 以下Microchip社)は本日、高データレートのモバイル機器アプリケーション向けに [50 Ω整合 5 GHz WLANフロントエンド モジュール\(FEM\)](#)である [SST11LF04](#)を発表しました。SST11LF04 は、トランスミッタ用のパワーアンプ(PA)、レシーバ用のバイパスモード対応低ノイズアンプ(LNA)、5 GHz WLAN接続用の低損失SP2T (Single-Pole Two-Throw)アンテナスイッチをコンパクトな 2.5x2.5x0.4 mm、16ピンQFNパッケージに集積しており、高データレートのモバイル機器に最適です。MCS9-HT80 変調と 80 MHz帯域幅を使った 1.75%ダイナミックEVMの場合で最大 16 dBm (3.3 V Vcc)と 17 dBm (5 V Vcc)、3% EVMの場合で 18 dBm (3.3 V)と 19 dBm (5 V)という高い線形出力を小型パッケージで達成したSST11LF04 は、IEEE 802.11a WLANシステムの通信範囲を拡大すると同時に、11acの最大データレート変調時に抜群の送信出力を実現します。レシーバのゲインは 12 dBで、入力の 1 dBコンプレッション ポイントは-6 dBm超です。LNAバイパスモードでは、レシーバの雑音指数(NF)は 2.5 dBで、入力圧縮レベルは-6 dBmです。

50 Ω 整合の 5 GHz FEM である SST11LF04 は、基板面積を抑えた高効率の機器設計を可能にし、市場投入までの期間を短縮します。高い線形出力により 802.11a/n/ac の動作をサポートし、高いデータレートを実現すると同時に、モバイル機器、マルチチャンネル アクセスポイント/ルータ、セットトップ ボックス等、小型機器に最適な小型パッケージを採用しています。

「Microchip 社は 2.4 GHz と 5 GHz の両方で電力付加効率(PAE)を高めた高信頼性のパワーアンプを提供しており、WLAN 市場向け RF パワーアンプの分野で確かな地位を確立しています。」と Microchip 社 RF 部門担当副社長の Daniel Chow は述べています。「今回発表したフロントエンドモジュールの SST11LF04 は、これまでと同じ動作信頼性を維持したままコンパクト化を図っています。幅広い温度レンジで高効率の動作と低ダイナミック EVM を実現し、レシーバの雑音指数を抑えたこの新しい FEM をモバイル機器、マルチチャンネル アクセスポイント/ルータ、セットトップ ボックス等の機器に採用する事で、超高データレートの 5 GHz 802.11ac システムの通信範囲が拡大します。」

Microchip announces new 5 GHz 50 ohm Matched WLAN Front End Module for IEEE 802.11a/n/ac applications  
2-2-2-2

## 開発サポート

SST11LF04 フロントエンド モジュールの評価用ボードは、Microchip 社から提供いたします。

## 在庫/供給状況

SST11LF04 は、本日より 2.5x2.5x0.4 mm、16 ピン QFN パッケージでサンプル出荷と量産出荷を開始いたします。本製品は 10,000 個単位で提供いたします。

詳細は、Microchip社または正規販売代理店にお問い合わせ頂くか、Microchip社のウェブページ(<http://www.microchip.com/get/K6WW>)をご覧ください。本プレスリリースに記載された製品をご購入頂くには、[microchipDIRECT](http://www.microchip.com/get/microchipDIRECT)のウェブページにアクセスするか、Microchip社の正規販売代理店にご連絡ください。

## リソース

高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickr でご覧ください(掲載に許可は不要です)。

- デバイス画像: <http://www.microchip.com/get/LR8L>
- ブロック図: <http://www.microchip.com/get/7TWB>

Microchip 社の最新情報をぜひフォローしてください。

- Microchip社製品ニュースのRSSフィード: <http://www.microchip.com/get/5AR2>
- Twitter: <http://www.microchip.com/get/3JU6>
- Facebook: <http://www.microchip.com/get/NPBC>
- YouTube: <http://www.microchip.com/get/TR3Q>

## Microchip 社について

Microchip社(NASDAQ: MCHP)は、マイクロコントローラ、ミックスドシグナル、アナログ、Flash-IPソリューションのトッププロバイダであり、全世界で数千を超える各種アプリケーションにおいて、低リスクの製品開発、総システムコストの削減、迅速な商品化の実現に貢献しています。Microchip社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、優れた技術サポート、確かな納期、高い品質を提供しています。詳細については、Microchip社のウェブページ(<http://www.microchip.com/get/C87E>)をご覧ください。

###

Note: Microchip 社の名称とロゴは、アメリカ合衆国および他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。その他本書に記載されている商標は、各社に帰属します。

タグ/キーワード: [5 GHz](#)、[フロントエンド モジュール](#)、[FEM](#)、[256 QAM](#)、[802.11ac](#)、[WLAN](#)、[MCS9](#)、[モバイル機器](#)

Microchip announces new 5 GHz 50 ohm Matched WLAN Front End Module for IEEE 802.11a/n/ac applications  
3-3-3-3

詳細については、以下にお問い合わせください。  
Daphne Yuen (Microchip 社): (852) 2943 5115  
(メール: [daphne.yuen@microchip.com](mailto:daphne.yuen@microchip.com))

山神、高田 (共同 PR): (03) 3571 5236  
(メール: [k-yamagami@kyodo-pr.co.jp](mailto:k-yamagami@kyodo-pr.co.jp))

報道関係者の方へ: このニュースリリースのメールによる配信については、共同 PR 株式会社 山神もしくは高田まで電話(03) 3571 5236 またはメール [k-yamagami@kyodo-pr.co.jp](mailto:k-yamagami@kyodo-pr.co.jp) でお問い合わせください。